公司代码：605111　　公司简称：新洁能

无锡新洁能股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本 142,821,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.75 元（含税），预计派发现金红利 82,122,075.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计拟转增 57,128,400 股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新洁能	605111	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖东戈	陈慧玲
办公地址	无锡市新吴区电腾路 6 号	无锡市新吴区电腾路 6 号
电话	0510-85618058-8101	0510-85618058-8101
电子信箱	Info@ncepower.com	Info@ncepower.com

2 报告期公司主要业务简介

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下“3972 半导体分立器件制造”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

分立器件行业是半导体产业中一个重要分支。据国家统计局规模以上工业统计数据显示，近几年来，分立器件行业规模以上企业主营业务收入占半导体行业规模以上企业主营业务收入的比重维持在 22%-25%之间。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。据中国半导体行业协会统计，半导体功率器件是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子（含燃油车和新能源汽车）、工业电子等电子产业。此外，新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏储能和光伏逆变等新兴应用领域逐渐成为半导体功率器件的重要应用市场，从而推动其需求增长。

近年来，半导体行业景气度持续保持较高水平。Semiconductor Intelligence 于 2021 年 8 月预期 2022 年全球半导体市场规模增长 15%，WSTS 于 2021 年 11 月预期增速 8.78%，而 IC Insights 最新于 2022 年 1 月预期 2022 年增速达 11%。

相比于全球半导体市场，中国半导体市场增速仍然领先全球，半导体产业持续稳定发展。根据中国半导体行业协会预测，2021 年至 2023 年我国半导体市场需求将有望分别达到 21,467.00 亿元、24,269.60 亿元和 27,633.40 亿元，2022 年及 2023 年中国半导体市场同比增速将分别扩大至 13.06%和 13.86%。

在半导体分立器件的细分领域，2011 年至 2020 年国内半导体分立器件市场需求保持了 10.67%的年均复合增长。根据中国半导体行业协会预测，2021 年中国半导体分立器件市场需求将达到 3,346.30 亿元，到 2023 年分立器件的市场需求将达到 4,393.20 亿元。从中长期来看，国内半导体市场需求仍将呈现较快的增长势头。

（1）主要业务

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件。通过持续的自主创新，公司在沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 以及 IGBT 等产品的设计研发方面拥有多项核心技术。公司的产品先进且系列齐全，广泛应用于汽车电子（含燃油车和新能源汽车）、工业电子、消费电子以及充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏逆变和光伏储能等领域。

（2）经营模式

公司主要为 Fabless 模式，并向封装测试环节延伸产业链，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业和全资子公司电基集成对芯片进行封装测试而成。公司全资子公司电基集成已建设先进封测产线并持续扩充完善，目前已实现部分芯片自主封测并形成特色产品。

（3）市场地位

公司为国内领先的半导体功率器件设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，公司连续五年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司基于全球半导体功率器件先进理论技术开发领先产品，是国内率先掌握超结理论技术、并量产屏蔽栅功率 MOSFET 及超结功率 MOSFET 的企业之一，是国内最早在 12 英寸工艺平台实现沟槽型 MOSFET、屏蔽栅 MOSFET 量产的企业。同时，公司是国内最早同时拥有沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 及 IGBT 四大产品平台的本土企业之一，产品电压已覆盖了 12V-1700V 的全系列产品，为国内 MOSFET、IGBT 等半导体功率器件市场占有率排名前列的本土企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,885,252,057.18	1,398,481,471.87	34.81	807,855,312.62
归属于上市公司股东的净资产	1,530,306,957.58	1,159,961,364.23	31.93	571,619,173.58
营业收入	1,498,271,279.34	954,988,968.12	56.89	772,536,915.73
归属于上市公司股东的净利润	410,461,760.71	139,354,220.84	194.55	98,209,485.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,830,298.50	134,787,126.04	198.12	87,627,361.26
经营活动产生的现金流量净额	450,884,685.73	80,659,974.13	458.99	75,126,606.71
加权平均净资产收益率(%)	30.62	18.49	增加 12.13 个百分点	18.80
基本每股收益(元/股)	2.90	1.21	139.67	0.92
稀释每股收益(元/股)	2.90	1.21	139.67	0.92

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	316,520,856.59	360,629,351.72	422,284,916.13	398,836,154.90
归属于上市公司股东的净利润	75,143,853.44	99,332,334.12	136,268,049.27	99,717,523.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,591,980.54	95,378,931.26	134,932,501.35	96,926,885.35
经营活动产生的现金流量净额	58,510,313.79	149,309,103.88	179,139,486.38	63,925,781.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

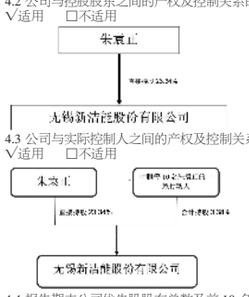
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,435
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,788
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
朱袁正	9,446,400	33,062,400	23.34	33,062,400	无		境内自然人
上海贝岭股份有限公司	1,376,700	7,376,700	5.21		无		境内非国有法人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-693,100	5,906,900	4.17		无		其他
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	252,700	4,272,700	3.02		无		其他
无锡国联创投基金企业（有限合伙）	-78,000	4,122,000	2.91		无		其他
无锡金投控股有限公司	539,340	3,881,340	2.74		无		境内非国有法人
朱进强		3,000,000	2.12		无		境内自然人
施罗德投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列中国 A 股(交易所)	2,889,263	2,889,263	2.04		无		其他
上海睿玲投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金	2,560,000	2,560,000	1.81		无		其他
宁波易联新能源汽车产业创业投资合伙企业(有限合伙)	-256,000	2,024,000	1.43		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	①上海金浦新明投资管理有限公司为金浦新投执行事务合伙人(委派代表为朱进强之配偶)，并持有金浦新投 0.10%的合伙份额。朱进强之配偶持有上海金浦新明投资管理有限公司 23.00%的股份并担任其总裁；②上海烜煜企业管理中心(有限合伙)持有金浦新投 0.96%的合伙份额。朱进强之配偶持有上海烜煜企业管理中心(有限合伙)80.00%的合伙份额，上海跃如投资管理有限公司持有上海烜煜企业管理中心（有限合伙）20.00%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，朱进强之配偶持有上海跃如投资管理有限公司 99.00%的股份并担任其法定代表人和执行董事。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入 149,827.13 万元，较去年同期增长 56.89%；其中主营业务收入 149,439.70 万元，较去年同期增长 56.75%；归属于上市公司股东的净利润 41,046.18 万元，较去年同期增长 194.55%；归属于上市公司股东的扣非净利润 40,183.03 万元，较去年同期增长 198.12%。业绩增长的主要原因系：2021 年度，受到疫情持续、电子元器件国产化加快、新兴应用领域兴起等因素的影响，功率半导体行业景气度日趋升高，上游产能日益紧张。围绕市场需求、客户需求以及行业发展趋势，公司积极进行研发升级与产品技术迭代；持续开发与维护供应链资源，争取更多的产能支持；同时，优化市场结构、客户结构及产品结构，开拓新兴市场与开发重点客户，最终实现经营规模和经济效益的较好增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

关于无锡新洁能股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告

保荐机构（主承销商）

广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

二零二二年三月

中国证券监督管理委员会：

根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220225 号）中《无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）、无锡新洁能股份有限公司（以下简称“申请人”、“发行人”、“公司”或“新洁能”）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“律师”）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“天衡会计师”）等中介机构对无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见所涉及的有关问题进行了认真的核查，对反馈意见问题予以详细回复。涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构分别出具专项审核意见或补充意见。现就反馈意见述及的问题向贵会详细回复如下，敬请审核。

说明：

如无特别说明，本反馈意见回复报告中的简称或名词释义与《广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票项目尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告”）中的简称或名词释义相同，本反馈意见回复报告的字体规定如下：

反馈意见所列问题	黑体加粗
对反馈意见所列问题的回复	宋体
对尽职调查报告的修订	楷体加粗

除特别说明外，本反馈回复中所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

1.申请人尚未取得募投项目所需全部土地使用权，请申请人说明相应用地的计划、取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策城市规划，募投项目用地落实的风险，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。

回复：

一、相应用地的计划、取得土地的具体安排、进度

发行人本次非公开发行募集资金总额不超过 145,000.00 万元（含 145,000.00 万元），募集资金投资项目 “第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化”、“功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化”、“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化”拟建于江苏省无锡市新吴区锡兴路与锡新二路交叉口西北侧，项目用地约 31,651.5 平方米，计划由发行人以出让方式取得，土地用途为工业用地。

根据《中华人民共和国土地管理法》第五十四条：“建设单位使用国有土地，应当以出让等有偿使用方式取得”、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》第四条：“工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一宗地有两个以上意向用地者的，应当以招标、拍卖或者挂牌方式出让”等相关规定，发行人取得本次募投项目用地的土地使用权需履行招拍挂程序。

根据对无锡高新区科技创新促进中心（无锡国家高新技术产业开发区管委会下属单位，负责牵头协助办理土地申请工作）的访谈，发行人取得募投用地的主要进展如下：

1、发行人 2021 年下半年与无锡高新区（新吴区）进行多次沟通并达成初步意向。根据 2021 年 11 月 1 日，无锡高新区科技创新促进中心出具的《关于无锡新洁能股份有限公司项目用地进展的说明》：“目前新洁能已与无锡高新区（新吴区）进行多次沟通并达成初步意向，正在准备招拍挂申请流程。预计新洁能取得本次项目规划用地的土地使用权不存在实质性障碍”。

2、发行人于 2021 年 12 月通过无锡高新区科技创新促进中心递交了《高新区项目地块、规划选址申请书》、《工业用地出让地块规划申请表》等申请文件，并已通过相关主管部门的审核。

3、目前项目用地正在进行土地招拍挂筹备工作，预计 2022 年 4 月完成筹备工作，满足招拍挂前置要求。

4、发行人预计于 2022 年 5 月完成本次募投项目用地的招拍挂手续，并签订土地出让合同，取得项目建设用地。目前主要工作包括土地招拍挂筹备、土地招拍挂、签订国有土地出让合同及办理土地使用权证书等，具体安排情况如下：

序号	事项	具体工作	预计完成时间
1	启动招拍挂前置申请程序	土地招拍挂筹备	2022 年 3-4 月
2	履行招拍挂程序	自然资源和规划部门发布国有建设用地使用权网上挂牌出让公告，竞买人缴纳竞拍保证金、参与竞拍并取得成交确认书，招拍挂流程一般为 15 个自然日	2022 年 5 月
3	签订土地出让合同	自然资源和规划部门组织签订国有建设用地使用权出让合同	招拍挂手续完成后一周左右
4	办理产权证书	发行人办理不动产证书	2022 年 5 月底

2022 年 3 月 9 日，无锡国家高新技术产业开发区管委会出具了《关于无锡新洁能股份有限公司项目用地进展的说明》（以下简称：《情况说明》）：“目前新洁能已与无锡高新区（新吴区）进行多次沟通并达成意向，摘地相关手续积极办理中。新洁能取得本次项目规划用地的土地使用权目前不存在实质性障碍。”

综上所述，本次募投项目的建设用地选址已完成，并取得了无锡国家高新技术产业开发区管委会的《情况说明》，后续审批工作发行人正在与无锡市自然资源和规划局积极稳步推进中，发行人预计将于 2022 年 5 月底前签订土地出让合同，取得募投项目建设用地。

二、是否符合土地政策城市规划

根据《新吴区国土空间规划近期实施方案土地利用总体规划图》、无锡国家高新技术产业开发区管委会出具的《情况说明》及对无锡高新区科技创新促进中心的访谈，无锡市新吴区锡兴路与锡新二路交叉口区块地块性质为工业用地。

根据无锡市新吴区人民政府《无锡市新吴区国土空间规划近期实施方案》（2021 年 2 月），“新吴区持之以恒实施产业强区战略，狠抓重大项目投入，大力发展战略性新兴产业。巩固扩大物联网、集成电路、大数据、云计算等新一代信息技术产业的领先优势，形成具有全球影响力数字经济高地。推进集成电路、生物医药等优势产业加快发展，培育更多千亿级产业集群。”

根据无锡市人民政府办公室《市政府办公室关于规范新型产业用地管理的通知》（2022 年 2 月），“精准服务高端产业。新型产业用地实行产业准入制度，准入目录应符合我市产业发展战略方向，包括地标产业：物联网、集成电路、生物医药；优势产业：高端装备、高端纺织服装、节能环保、特色新材料、新能源、汽车及零部件、软件与信息服务业；未来产业：人工智能、量子科技、化合物半导体、氢能和储能、深海装备等。产业准入目录根据市政府产业政策动态调整。”新洁能主要经营半导体功率器件，所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

发行人本次募投项目属于国家产业政策鼓励发展的产业领域，已取得新吴区行政审批局的项目备案证以及无锡市行政审批局的环评批复。项目用地已取得新吴区发改委准入产业意见“根据高新区（新吴区）产业发展导向及项目用地规范，该地块拟引入新型电子元器件（功率器件）项目”，本次募投项目系投资功率器件产业，符合区域产业规划要求。

根据无锡高新区管理委员会出具的《情况说明》和对无锡高新区科技创新促进中心的访谈，募投项目所在地块用地性质为工业用地，符合无锡市土地利用总体规划及新吴区产业规划、土地政策。

综上，发行人募投项目用地符合土地政策、城市规划。

三、募投项目用地落实的风险

根据无锡国家高新技术产业开发区管委会出具的《情况说明》以及对无锡高新区科技创新促进中心的访谈，目前新洁能已与无锡高新区（新吴区）进行多次沟通并达成意向，摘地相关手续积极办理中，计划于 2022 年 5 月左右进行招拍挂程序，并签订土地出让合同，预计 5 月底取得项目建设用地。取得募投项目用地土地使用权不存在实质性障碍。

综上，发行人取得募投项目用地的预期较为明确，预计无法取得该土地使用权的风险较小。

四、如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等

根据无锡国家高新技术产业开发区管委会出具的《情况说明》：“如因供地原因影响新洁能项目建设，高新区将尽力协调区内其他地块，全力保障新洁能项目后续实施。”

根据对无锡高新区科技创新促进中心的访谈，无锡高新区科技创新促进中心表示“如拟申请地块相关审批时间过长影响新洁能正常开工建设或新洁能未能通过招拍挂取得相关地块的，我们可以尽最大努力协调高新区范围内其他地块，保障新洁能项目后续实施。”

发行人出具了《关于无锡新洁能股份有限公司取得募投项目用地相关事宜的承诺》：“公司本次募投项目所在地土地储备充足，募投项目对地块无特殊要求，公司也已考察实施地点周围地块，如募投用地取得无法落实，届时公司将尽快选取附近其他可用地块或采取其他切实可行的措施，以避免对募投项目的实施产生重大不利影响。”

综上，发行人尚未取得的募投项目用地将于政府部门完成相关审批后进行招拍挂，根据无锡国家高新技术产业开发区管委会出具的《情况说明》以及对无锡高新区科技创新促进中心的访谈，上述事项的推进不存在实质性障碍和不确定性。发行人已与当地政府沟通了替代措施，若当前地块的审批时间过长影响项目开工建设的，无锡国家高新技术产业开发区管委会将积极协调园区内其他地块供发行人使用，以保证该项目的实施进度不受影响，且如募投用地取得无法落实，届时公司将尽快选取附近其他可用地块或采取其他切实可行的措施，以避免对募投项目的实施产生重大不利影响，故发行人募投项目用地无法落实的风险较小。

【中介机构核查意见】

（一）核查程序

1、取得发行人募投项目备案文件及环评批复文件，了解其具体履行的程序；

2、查阅《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律法规，了解发行人取得本次募投项目用地的土地使用权需履行的程序；

3、查阅无锡市及无锡市新吴区的土地规划政策及产业政策，了解发行人本次募投项目用地是否符合用地规划及产业政策；

4、对无锡高新区科技创新促进中心进行访谈，并取得无锡国家高新技术产业开发区管委会出具的《情况说明》；

5、与发行人募投项目负责人等沟通确认，了解发行人取得本次募投项目用地的土地使用权的具体安排、进度及用地落实的风险和对策，并取得了发行人出具的《关于无锡新洁能股份有限公司取得募投项目用地相关事宜的承诺》。

（二）核查意见

经核查，保荐机构及申请人律师认为：

1、发行人本次募投项目的建设用地选址已完成，目前正在进行招拍挂准备工作，发行人预计将于 2022 年 5 月完成本次募投项目用地的招拍挂手续并签订土地出让合同，取得募投项目建设用地；

2、发行人本次募投项目用地符合土地政策、城市规划；

3、发行人取得募投项目用地的预期较为明确，预计无法取得该土地使用权的风险较小；

4、发行人已与当地政府沟通了替代措施，如因供地原因影响新洁能项目建设，无锡国家高新技术产业开发区管委会可以协调高新区范围内其他地块供新洁能募投项目使用，保证项目后续实施，且如募投用地取得无法落实，届时公司将尽快选取附近其他可用地块或采取其他切实可行的措施，以避免对募投项目的实施产生重大不利影响。

2.请申请人说明申请人及控股、参股子公司是否从事房地产业务，募投项目是否涉及房地产业务，是否存在募集资金变相投向房地产。请保荐机构和律师核查并发表意见。

回复：

一、申请人及控股、参股子公司是否从事房地产业务

（一）发行人及控股企业、参股企业经营范围不涉及房地产业务

截至本反馈意见回复出具之日，发行人拥有 4 家控股企业，2 家分公司和 4 家参股企业，具体情况详见下表：

序号	名称	经营范围	与发行人关系
1	新洁能香港	电力电子元器件的研发、生产、销售；集成电路的研发、销售和贸易	全资子公司，发行人持有其 100%的股份
2	电基集成	电子元器件、电力电子元器件及半导体模块产品及其它电子产品的设计、制造、销售；集成电路及其它电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、制造、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	全资子公司，发行人持有其 100%的股份
3	富力鑫	一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股企业，发行人持有其 64.00%的合伙份额
4	金兰半导体	一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；集成电路设计；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	全资子公司，发行人持有其 100%的股份
5	新洁能深圳分公司	电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。环境保护专用设备的制造、销售。	发行人分公司
6	新洁能宁波分公司	电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	发行人分公司
7	源微半导体	销售：电子元器件、电子产品、照明器材、高低压电器；新能源汽车充换电设施建设运营；电子技术推广服务；新能源技术推广服务；计算机软件开发及销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	参股企业，发行人持有其 8.67%的股份
8	国硅集成	一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子产品销售；销售代理；国内贸易代理；光电子器件制造；电子元器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	参股企业，发行人持有其 5.00%的股份
9	临盐投资	一般项目：股权投资；实业投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	参股企业，发行人持有其 99.78%的合伙份额
10	泰兴永志	集成电路引线框架、铆带、电连接器、LED 灯具研发、制造、销售；城市及道路照明工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	参股企业，发行人持有其 1.6393%的股份

富力鑫及临盐投资的合伙协议已明确约定投资方向，其经营范围中涉及的投资均围绕发行人主营业务和发展战略展开，属于围绕产业链上下游相关领域的投资，不得投资于房地产相关业务。

因此，发行人及控股企业、参股企业的经营范围均不涉及房地产相关业务，发行人及其控股企业亦不存在取得房地产开发资质的情况，相关公司未从事房地产开发经营活动。

（二）发行人及其控股企业拥有的土地、房产不涉及房地产业务

发行人及其控股企业拥有产权的土地性质均为工业用地；发行人及其控股企业拥有产权的房屋均用作厂房、仓库、研发、办公用房等与发行人主营业务或配套需求相关用途，不涉及房地产业务。具体情况如下：

1、土地使用权

截至本反馈意见回复出具之日，发行人及其控股企业拥有土地使用权共 1 宗，具体情况如下表：

序号	土地使用证号	宗地位置	用途	面积(m2)	终止日期	使用权人	取得方式	实际用途
1	苏(2021)无锡市不动产权第 0263180 号	电腾路 6	工业用地/工业、交通、仓储	15,271.70	2067.09.03	电基集成	出让	厂房及仓库、研发、办公

2、房屋建筑

截至本反馈意见回复出具之日，发行人及其控股企业拥有房屋建筑 1 处，具体情况如下表：

序号	房屋所有权证号	地址	建筑面积(m2)	登记日期	所有权人	取得方式	实际用途
1	苏(2021)无锡市不动产权第 0263180 号	电腾路 6	21,311.36	2021.10.20	电基集成	自建	厂房及仓库、研发、办公

3、租赁的房产

截至本反馈意见回复出具之日，发行人拥有租赁房产 2 处，具体情况如下表：

序号	出租方	地址	建筑面积(m2)	租赁期限	实际用途
1	定军山文化产业发展(深圳)有限公司	深圳市宝安区西乡街道臣田研发大楼 1701、1702、1703、1707	726.85	2020.11.1-2025.12.31	办公
2	浙江升和资产管理有限公司	宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 10-6	153.40	2019.09.24-2022.10.03	办公

4、其他非流动资产中涉及的新购房产

2021 年 11 月，发行人以自有资金向华润新鸿基房地产（无锡）有限公司购买位于无锡市滨湖区太湖街道湖滨路金石路西北路地块大剧院路项目办公用房共计 9 间，合计建筑面积约 1,100 平方米，上述房产为期房，目前尚在施工期，待建成后交付，相关房产所占用的土地用途为办公用途，未来将作为发行人日常办公大楼，不用于炒房或从事出租等房地产相关业务。

综上，发行人及其控股企业、参股企业经营范围不涉及房地产业务，发行人及其控股企业拥有的土地、房产不涉及房地产业务，未从事房地产开发经营、炒房或出租房地产等活动，发行人及其控股企业、参股企业未从事房地产业务。

二、募投项目是否涉及房地产业务，是否存在募集资金变相投向房地产

（一）本次募投项目

公司本次募投资金用于“第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化”、“功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化”、“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化”项目及补充流动资金。

上述项目建设地点位于江苏省无锡市新吴区锡兴路与锡新二路交叉口，项目占地面积约 31,651.5 平方米。发行人本次募投项目拟新建的建筑物包括封测厂房、研发大楼、仓库、废水站、氮氢气站等，合计预计新增建筑面积 55,710.00m2。上述募投项目投资所涉厂房、研发大楼、环保设施和辅助设施等均为公司产品生产、研发而建造，紧紧围绕公司主营业务，符合公司的经营特点，具有明确的用途，拟购置的土地均为工业用地，不涉及房地产投资。本次募集资金投资项目不会导致募集资金用于或者变相用于房地产业务。

（二）前次募投项目

发行人前次募投项目新增的建筑物主要位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。截至本反馈回复出具日，前次募投项目土建工程建设及装修已达到预定可使用状态并转固。其中土建建设内容包括：厂房、办公楼、仓库等，其中地上建筑五层、地下建筑一层，公司及时办理了新的房屋所有权证，新增建筑面积为 12,422.56 m2。发行人前次募投项目新增的建筑物均为满足前次募投项目所需生产厂房、研发场地、生产配套场地，不涉及房地产投资。前次募投项目募集资金未用于或者变相用于房地产业务。

发行人已就公司及控股企业、参股企业未从事房地产业务、公司本次募投项目和前次募投项目不涉及房地产投资、公司不存在募集资金变相投向房地产等事项出具了相关承诺。

综上，发行人及控股企业、参股企业未从事房地产业务，募投项目不涉及房地产业务，不存在募集资金变相投向房地产的情形。

【中介机构核查意见】

（一）核查程序

1、获取发行人及其控股企业、参股企业的营业执照、工商登记资料；

2、获取发行人及其控股企业提供的拥有的土地使用权、房屋所有权权属证书、租房合同及新购办公用房的合同、付款凭证等；

3、取得了发行人出具的关于不涉及房地产业务的承诺函；

4、获取发行人本次募投项目及前次募投项目可行性分析报告，实地察看发行人前次募投项目新增房屋建筑物及其使用情况。

（二）核查意见

经核查，保荐机构及申请人律师认为：

发行人及控股企业、参股企业未从事房地产业务，募投项目新增建筑围绕公司主营业务，具有明确的用途，募投项目不涉及房地产业务，不存在募集资金变相投向房地产的情形。

3.请保荐机构和律师核查说明募投项目产业化的具体内容，本次募投项目是否符合国家相关产业政策，募投项目立项备案的具体情况，是否还需要在相关部门履行除立项备案之外的其他程序或符合相关部门的其他要求。请保荐机构和律师核查并发表意见。

回复：

一、募投项目产业化的具体内容

公司本次募集资金用于“第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化”、“功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化”、“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化”项目及补充流动资金。募投项目产业化的具体内容如下：

项目名称	主要产品	产品产能(万只)
第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化	SiC/GaN 功率器件	2,640.00
功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化	功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）	145,200.00
SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化	SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块	362.60

本次募投项目紧紧围绕公司主营业务并进行产品延伸，项目的实施有助于公司顺应政策导向与行业发展趋势，提高公司自主创新能力，丰富产品种类，推进产品结构升级，从而增强客户服务能力和市场竞争力，巩固国内市场领先地位并缩小与国际半导体功率器件一流企业的技术差距，提高国际竞争力。

二、本次募投项目是否符合国家相关产业政策

（一）本次募投项目均符合国家产业结构调整的要求

发行人募投项目产品主要为第三代半导体 SiC/GaN 功率器件产品以及功率驱动 IC、功率集成模块和智能功率模块等产品，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及本次募投项目相关可行性分析报告，上述产品属于“第一类鼓励类——二十八、信息产业——22、半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”。发行人本次募投项目属于国家鼓励类产业。

（二）本次募投项目属于国家